

# GWS-300M

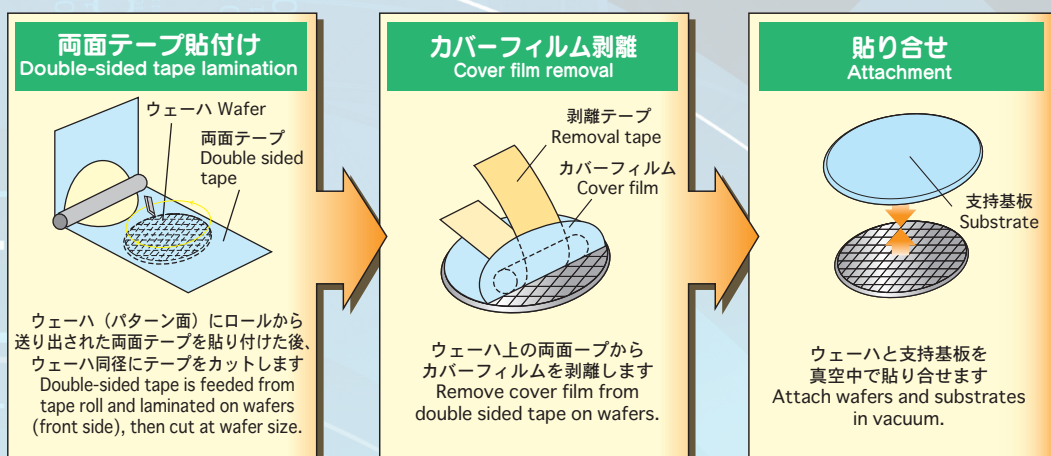
## ウェーハ / 支持基板貼付装置 WAFER/SUBSTRATE ATTACHING MACHINE

【概要 - Outline -】

◆本装置は、ウェーハ表面への両面テープの貼付け、カバーフィルムの剥離、ウェーハと支持基板の貼り合せを行います。  
This machine laminates double-sided tape onto wafers, remove cover film on it, and attaches wafers and substrates.

ウェーハと支持基板の貼り合せは、タカトリ独自の真空チャンバー方式の採用により、気泡の混入が無く、  
Lamination of wafer and double-sided tape & attachment of wafers and substrates is made in Takatori unique vacuum chamber.

貼付け圧力も一定で均一な貼り合せが可能です。  
So the laminating without air bubbles and with uniform attaching pressure is available.



仕様 Specification	GWS-300M
スループット Throughput	30~40 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェーハサイズ Wafer Size	8・12 inch
装置寸法 Demension	W 2,400 × D 2,400 × H 1,800 mm
重量 Weight	1,200 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。  
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.